

# 惠州回收iscsemi固电半导体IC

产品名称	惠州回收iscsemi固电半导体IC
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

陈列引脚封装。插装型封装之一，其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都采用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下，多数为陶瓷PGA，用于高速大规模逻辑LSI电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm，引脚长约3.4mm，引脚数从64到447左右。为降低成本，封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基板代替。

也有64~256引脚的塑料PGA。另外，还有一种引脚中心距为1.27mm，引脚长度1.5mm~2.0mm的短引脚表面贴装型PGA（碰焊PGA），比插装型PGA小一半，所以封装本体可制作得不怎么大，而引脚数比插装型多（250~528）。

LGA（land grid array）

触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态电极触点的封装。装配时插入插座即可。现已实用的有227触点（1.27mm中心距）和447触点（2.54mm中心距）的陶瓷LGA，应用于高速逻辑LSI电路。LGA与QFP相比，能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外，由于引线的阻抗小，对于高速LSI是很适用的。

XTR115UA

XTR116UA

ISO124U

OPA322AIDBVR

TCA9555RTWR

TRS3253EIRSMR

INA240A1PWR

INA240A2PWR

ADS1112IDGSR

ADS7953SRHBR

DAC7611U

TS3A27518ERTWR

INA282AIDR

DRV8832DGQR

TL4242DRJR

UC3710T

UCC27712DR

UCC27524ADR

TRF7962ARHBR

TRF7970ARHBR

TRF7964ARHBR

TPS54478RTER

TPS74901RGWR

OPA4197IDR

INA821IDR

OPA4197IPWR

TPS23861PWR